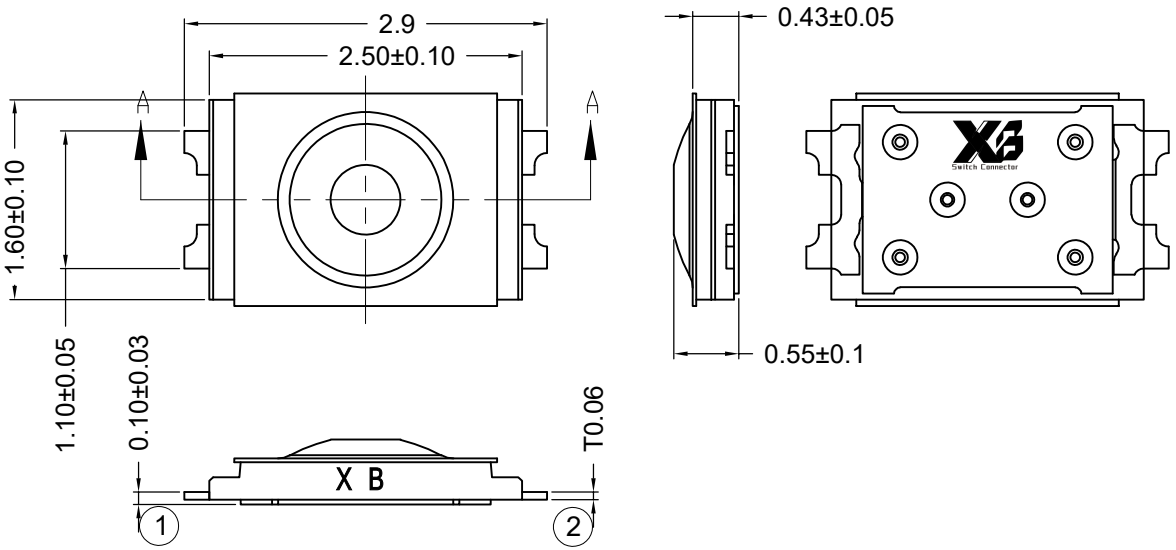
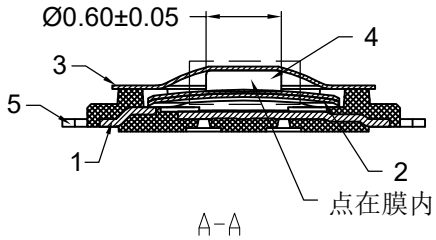
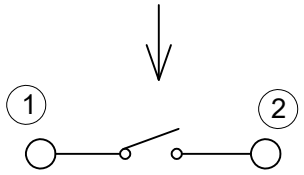
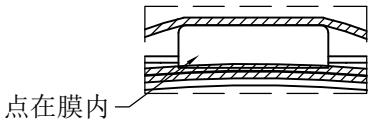
序 号	高度(H)
1	0.55





Circuit Diagram

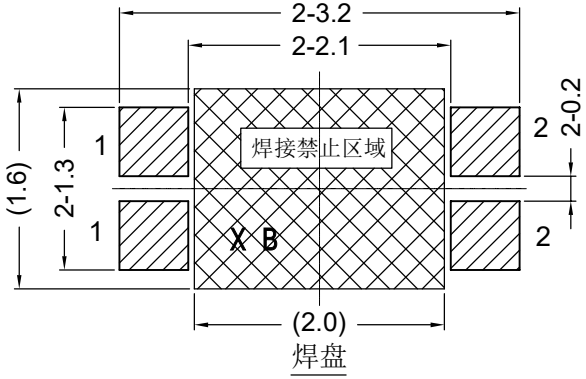




SCALE B=2/1

丝网厚度为0.08±0.01mm
相对于焊盘，开口率为60~100%。
（推荐80%）

PCB.layout



焊锡涂布量波动有可能导致实装焊接通不良，
因此请使用推荐焊盘和丝网。

▨：推荐焊盘区域
▩：焊接禁止区域
▩部分请不要设置焊盘或导线

如设置焊盘或志线时，为避免金属部分露出，请进行绝缘涂层处理。
金属部分露出的话，通过焊锡球有可能和开关背面的端子发生短路。
并且，由于铜箔的厚度、焊盘的布局等不同，产生凹凸的段差，有可能会对开关斜、与焊锡的接合状态、助焊剂侵入等问题产生影响。
因此，使用前请进行事前验证。

序 号	名 称	数量	材 料	备 注
5	端子	1	C5210-H	镀银
4	胶点	1	聚酰亚胺	黑色
3	白膜	1	聚酰亚胺	白色(透明)
2	弹片	2	SUS301-Ag0.5	单面镀银
1	塑胶底座	1	PA	黑色

主要技术指标：
Main Specifications:

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐 压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	按压力 Operating force	行 程 Travel	寿 命 Life
-30℃~+85℃	Max50 mA12V DC Min10 μA12V DC	≤50mΩ	100V.AC.1Min	≥100MΩ	160±50gf	0.13±0.05	200000次

单位:MM	类型：轻触开关	型号：TAF01-BWJ-R	图幅：A4		第一页 共一页	
			线性公差：	角度公差：	比例：	投影视角：
			±0.1	±1.5°	1:1	3
设 计： wbj		东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Mark Electronic Technology Co. ,Ltd.				
审 核： wbj						
批 准：						

RoHS